



平成 18 年 9 月 26 日

報道関係各位

社団法人 日本ロボット工業会

『2006 実装プロセステクノロジー展』
『JISSO/PROTEC フォーラム・ジャパン 2006』
開催のご案内

社団法人日本ロボット工業会（JARA / 会長：井村健輔 株式会社不二越 代表取締役社長）は、来る 10 月 4 日（水）から 6 日（金）までの 3 日間、幕張メッセ（千葉県美浜区）にて、マウンタメーカーが一堂に会する唯一の実装技術専門展示会『2006 実装プロセステクノロジー展』を開催いたします。

8 回目を迎える本展は、“Jisso 最前線 - ここから明日のビジネスへ - ”を開催テーマとして、電子部品実装機をはじめとする Jisso プロセスとその関連製品の最新成果を一堂に集めた専門展として開催します。

今回の開催規模は、出展者 70 社・団体が 503 小間となり、3 日間で約 10,000 名の来場者を見込んでいます。

また、社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）と共催で同時開催する「JISSO/PROTEC フォーラム・ジャパン 2006」では、大塚寛治氏（明星大学 特別顧問 / 社団法人エレクトロニクス実装学会 会長）による基調講演（聴講無料）をはじめ、トレンド、機器セット、先端実装技術、電子部品、実装設備、半導体 PKG、バルク実装、鉛フリー、プリント配線板の 9 つの分野で計 35 セッション（有料 / 別記プログラム参照）にて、Jisso プロセスに関する最新技術の成果発表を行うほか、発表内容を具体的に理解していただくため、展示会場内の「先端実装システム展」にて最先端技術を紹介します。

なお、公式 Web Site にて、入場事前登録並びに聴講参加申込を受付中です。事前登録により入場が無料となり、また本展の入場証で、幕張メッセ（1～8 ホール）にて開催中の「CEATEC JAPAN 2006」への入場が可能となります。URL は次のとおりです。

www.jisso-protec.com

報道関係各位におかれましては、是非ともご来場の上、ご取材くださいますようお願い申し上げます。なお、ご来場の際には、会場入口横に設置するプレスルームにて、プレス証を発行いたしますので、お立ち寄りくださいますようお願い申し上げます。

以上

主催：  社団法人 日本ロボット工業会

www.jisso-protec.com

『(第8回) 2006 実装プロセステクノロジー展』開催概要

- 名 称 : (第8回) 2006 実装プロセステクノロジー展
Jisso Process Technology Exhibition 2006 (略称: JISSO PROTEC 2006)
- テ ー マ : Jisso最前線 - ここから明日のビジネスへ -
- 会 期 : 2006年10月4日(水) ~ 6日(金) 3日間
- 会 場 : 幕張メッセ / 展示ホール 9・10
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2 - 1
- 開場時間 : 10月4日(水)・5日(木) 10:00 ~ 17:00
10月6日(金) 10:00 ~ 16:00
- 主 催 : 社団法人日本ロボット工業会 (Japan Robot Association: JARA)
電話: (03)3434-2919 FAX: (03)3578-1404 URL: www.jara.jp
- 入 場 : 全来場者登録入場制
* インターネット事前登録 / 入場無料
* 当日入場料 / 一般: 1,000 円・学生: 500 円
- 後 援 : 経済産業省、日本放送協会、社団法人日本民間放送連盟、
東京商工会議所、独立行政法人日本貿易振興機構
- 協 賛 : 社団法人電子情報技術産業協会、社団法人エレクトロニクス実装学会、
社団法人日本ロボット学会、社団法人日本半導体製造装置協会、
財団法人製造科学技術センター、社団法人日本電子回路工業会
情報通信ネットワーク産業協会、
社団法人日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会、
IPC SMEMA Council (IPC: Association Connecting Electronics Industries)
- 運 営 : 有限責任中間法人日本エレクトロニクスショー協会
(Japan Electronics Show Association: JESA)

本件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

有限責任中間法人日本エレクトロニクスショー協会 担当: 石崎
電話: (03)5402-7601 FAX: (03)5402-7605 E-mail: contact@jisso-protec.com

JISSO PROTEC プレスルーム (10月4日~6日の間、幕張メッセに設置します。)
担当: インターメディコム・近藤 電話: (043)299-0340 FAX: (043)299-0341



JISSO PROTEC FORUM 2006 プログラム

10月4日(水)

基調講演(無料)

10:30 ~ 12:00

「エレクトロニクスの新分野を拓くキーテクノロジー 最先端 Jisso 技術」

大塚 寛治 氏[明星大学 特別顧問 / 社団法人エレクトロニクス実装学会 会長]

トレンドセッション 「転換期を迎える日本の電子産業」 - 国際競争力強化に向けて -

* 「水平分業の終焉と日本企業の勝機」(12:45 ~ 13:45)

山本 直樹 氏[ATカーニー株式会社 ヴァイスプレジデント]

* 「デジタル家電におけるメーカーの戦略」(13:45 ~ 14:45)

金澤 洋平 氏[日興シティグループ証券株式会社 株式調査部 ディレクタ]

機器セットセッション 「“日本の強さ”携帯機器の実装技術」

* 「世界最小 0.85 インチ HDD の実装技術」(15:05 ~ 15:45)

八甫谷 明彦 氏[株式会社東芝 青梅事業所 実装開発センター]

実装開発第1担当 グループ長]

* 「携帯電話の鉛フリー実装技術と諸問題への対応」(15:45 ~ 16:25)

志村 俊幸 氏[ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社]

JP 部門 要素技術部 第2チーム]

* 「Made in JAPAN ウルトラライトモバイル PC の実装技術」(16:25 ~ 17:05)

角井 和久 氏[富士通株式会社 実装技術開発センター]

コンポーネント実装技術グループ プロジェクト部長]

先端実装技術セッション 「電子機器の小型化を支える先端テクノロジー」

* 「System in Package 流通促進のための提言」(12:45 ~ 13:25)

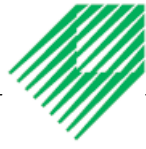
間仁田 祥 氏[JEITA 電子 SI パッケージング技術専門委員会 委員長]

* 「電子ペーパーの最新動向」(13:25 ~ 14:05)

檀上 英利 氏[凸版印刷株式会社 機能性部材事業推進部電子ペーパー担当]

* 「モバイル電子機器用燃料電池の動向」(14:05 ~ 14:45)

本田 進 氏[実装技術 NPO 法人サーキットネットワーク 理事]



電子部品セッション 「先端実装技術を支える部品テクノロジー」

- * 「導電性高分子電解コンデンサの技術動向と実装技術」(15:05 ~ 15:45)
田中 浩司 氏[三洋電機株式会社
電子デバイスカンパニー 技術開発U 技術企画課]
- * 「積層セラミックコンデンサの小型化動向と実装技術」(15:45 ~ 16:25)
田中 雪夫 氏[株式会社村田製作所
コンポーネント事業本部 技術開発統括部 実装技術部 部長]
- * 「RoHS 規制物質の迅速で高精度な評価法」(16:25 ~ 17:05)
大石 昌弘 氏[TDK 株式会社 素材解析センター科学分析G]

10月5日(木)

実装設備セッション 「進化する実装技術に対応する実装設備 最前線」

- * 「0402 微小チップ実装と設備」(12:35 ~ 13:25)
大野 勝彦 氏[ソニーマニュファクチャリングシステムズ株式会社
設備機器事業部 実装機器事業室 マネージャー]
- * 「次世代モバイル実装技術」(13:25 ~ 14:15)
森田 健 氏 / 友保 和彦 氏[パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社
電子部品実装ソリューションビジネスユニット]
- * 「これからの先端実装に必要な技術」(14:15 ~ 15:05)
服部 友彦 氏[富士機械製造株式会社
技術開発センター 技術開発グループ 課長]
- * 「最先端実装技術～印刷から搭載まで～」(15:20 ~ 16:10)
楠木 寿幸 氏 / 大川 直尚 氏[ヤマハ発動機株式会社
IMカンパニー マウンター技術グループ]
- * 「メタルマスクの要らない印刷機:MY500」(16:10 ~ 17:00)
榊 寿光 氏[マイデータ・オートメーション株式会社 営業技術]

半導体 PKG セッション 「デジタル家電を拓く SiP 技術の将来動向」

- * 「チップ積層 SiP から 3D/TSV 技術への革新」(12:35 ~ 13:15)
中島 宏文 氏[NEC エレクトロニクス株式会社
先端デバイス開発事業部 シニアエキスパート]



- * 「SMT 工法を用いた最新 SiP・PoP 実装技術」(13:15 ~ 13:55)
折井 靖光 氏[日本アイ・ピー・エム株式会社
エンジニアリング&テクノロジーサービス 高密度実装技術開発部長]
- * 「EAD型SiP技術」(13:55 ~ 14:35)
若林 猛 氏[カシオ計算機株式会社 要素技術統括部 高密度実装開発部 部長]
- * 「DIC法による熱変計測器を用いたシミュレーションモデルの構築」(14:35 ~ 15:15)
西尾 俊彦 氏[日本アイ・ピー・エム株式会社
エンジニアリング&テクノロジーサービス 技術理事]
- * 「SiP 対応薄チップ化技術」(15:30 ~ 16:10)
林 智雄 氏[株式会社東京精密 半導体社 B.G.グループ 主査]
- * 「SiP 対応ワイヤボンド技術」(16:10 ~ 16:50)
新井 一弘 氏[株式会社新川 応用技術部 主任]
- * 「SiP 対応樹脂封止技術」(16:50 ~ 17:30)
姫野 智則 氏[TOWA 株式会社 マーケティング部 モールド課 主務]

10月6日(金)

バルク実装セッション 「Jisso 最前線“バルク実装時代”」

- * 「バルク実装に関する最新動向と新しいバルク包装の提案」(10:35 ~ 11:05)
小林 丈二 氏[株式会社村田製作所 コンポーネント事業本部
技術開発統括部 実装技術部 実装技術課 課長]
- * 「チップ抵抗器のバルク実装」(11:05 ~ 11:35)
三浦 秀行 氏[釜屋電機株式会社 営業技術グループ マネージャー]
- * 「多品種変量セル生産におけるインライン実装でのバルクの取組」(11:35 ~ 12:05)
森 祐介 氏[SUNX 株式会社 生産技術部 生産技術課 課長]
- * 「クリーンルームにおけるバルク実装と混入対策事例」(12:05 ~ 12:35)
牧 修 氏[ソニーイーエムシー株式会社 幸田テック 実装製造部1課]

鉛フリーセッション 「鉛フリー実装は新ステージへ」

- * 「ウイスカ低減化工法: JMI(JVC マイクロアイランド)方式とメッキ技術」(13:30 ~ 14:10)
竹内 誠 氏[日本ビクター株式会社 生産技術本部
生産技術研究所 実装技術グループ 主幹技師]

- * 「ウイスカ制御 Pb フリーはんだ合金」(14:10 ~ 14:50)
林田 喜任 氏[タムラ化研株式会社 実装材料開発部]
- * 「はんだ中の鉛含有量 0.1%以下の簡易検査装置」(14:50 ~ 15:30)
中島 邦夫 氏[G・W・インターナショナル株式会社
ケミカル開発研究所 取締役所長]
- * 「鉛フリーはんだ技術の最新動向」(15:45 ~ 16:25)
豊田 良孝 氏[千住金属工業株式会社 開発・技術部 課長]
- * 「低温鉛フリーはんだ Sn-Zn 系はんだの最新動向」(16:25 ~ 17:05)
萩尾 浩一 氏[ニホンゲンマ株式会社 技術部 次長]

プリント配線板セッション 「次世代 SiP を支援する設計ツールと評価システム」

- * 「最新プリント配線板技術動向」(10:35 ~ 11:15)
宇都宮 久修 氏[インターコネクション・テクノロジー株式会社 代表取締役]
- * 「SiP サブストレートと部品内蔵技術の設計評価支援」(11:15 ~ 11:45)
友景 肇 氏[福岡大学 電子情報工学科 教授]
- * 「SiP サブストレートと部品内蔵技術の設計解析技術」(11:45 ~ 12:35)
杉浦 健 氏[福菱セミコンエンジニアリング株式会社
分析評価センター 副センター長]

講演内容は変更になる場合がありますので、予めご了承ください。